

Lehm-Dämmputz leicht Art. 05.036, 05.236



- Leicht und wärmedämmend
- Als flächige Minimaldämmung
- Unter Innendämmplatten



Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Warum den Raum unter Innendämmplatten verschenken? Im Vergleich zu normalen Lehmputzmörteln verbessern Auffütterungslagen aus Lehm-Dämmputz den Wärmetransport durch die Wand deutlich. Lehm-Dämmputz ist außerdem Problemlöser für viele Fälle, z.B. bei Fensterlaibungen oder zur flächigen Minimaldämmung. Er ist als Grundlage für alle groben und feinen Claytec-Lehmdeckputze geeignet.

Lehm-Dämmputz leicht

Art. 05.036, 05.236

Lehmputzmörtelart Lehmputzmörtel als Leichtlehmwerkmörtel. Erdfeucht 05.036 und 05.236.

Anwendung Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Handputz. Als dicklagiger Ausgleichputz unter Innendämmplatten, für unebene Fensterlaibungen und konische Putzlagen, auf Wärmebrücken und einbindenden Wänden und Decken, als flächige Minimaldämmung.

Zusammensetzung Lehm, Bims 5 mm, Korngruppe, Überkorngröße nach DIN 0/4, < 8 mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh

Herkunftsland Deutschland

Baustoffwerte Trocknungsschwindmaß 2%. Festigkeitsklasse S I. Biegezugfestigkeit 0,4 N/mm² Druckfestigkeit 1,0 N/mm². Haftfestigkeit 0,10 N/mm². Rohdichteklasse 1,0 (Rohdichte 960 kg/m³). Wärmeleitfähigkeit 0,19 W/m·K. µ-Wert 5/10. Wasserdampfsorptionsklasse WS III. Baustoffkl. B2*.

Lieferformen, Ergiebigkeit Erdfeucht 05.036 in 0,9 t Big-Bags (ergibt 675 l Putzmörtel, 45 m² Fläche bei D= 1,5 cm)
Erdfeucht 05.236 in 0,45 t Big-Bags (ergibt 340 l Putzmörtel, 23 m² Fläche bei D= 1,5 cm)

Lagerung Trocken lagern. Erdfeuchter Lehm-Dämmputz leicht soll spätestens 3 Monate nach der Herstellung verarbeitet werden. **Erdfeuchte Ware muss im Winter vor Durchfrieren geschützt gelagert werden, da sonst die Verarbeitbarkeit während des Frostes beeinträchtigt ist.**

Mörtelbereitung Unter Wasserzugabe von ca. 20% mit handelsüblichen Freifall-, Teller- und Trogzwangsmischern, in kleinen Mengen auch mit dem Motorquirl oder von Hand.

Putzgrund Lehmputze haften nur mechanisch. Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber, frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Als Grundierung ist bei Bedarf DIE ROTE für grobe Lehmputze (CLAYTEC 13.435-.430) geeignet. Zum Binden von Oberflächenstaub Untergrund ggf. Vornässen (Sprühnebel). Rohrgewebe muss trocken sein. Filmbildende Altanstriche entfernen.

Putzauftrag Der Mörtel wird mit der Kelle angeworfen oder aufgezogen. Minimale und maximale Auftragsdicke in der Regel 8 und 15 mm, abhängig vom Untergrund bis 35 mm möglich. Die Mörtelkonsistenz ist auf die Auftragsstärke abzustimmen. Der Auftrag von YOSIMA Lehm-Designputzen erfordert eine gut abgeriebene, ebene Oberfläche (zusätzlicher, besonderer Arbeitsgang) in der Regel einen dünnen Überzug mit Lehm-Oberputz fein 06.

Verarbeitungsdauer Da kein chemischer Abbindeprozess stattfindet, ist das Material abgedeckt über mehrere Tage verarbeitungsfähig.

Trocknung Nach dem Auftrag muss für rasche Trocknung gesorgt werden, z.B. mittels Querlüftung (24 Std. pro Tag alle Fenster und Türen geöffnet) oder Trocknungsgeräte. Bei kritischen Bedingungen ist die Trocknung gemäß DIN 18550-2 zu protokollieren. Details siehe dort oder im CLAYTEC „Arbeitsblatt Lehmputze“. Wir geben gerne gesondert Auskunft.

Mikrobiologische Grundkonzentration: Produkt mit Pflanzenfasern, erdfeucht. Nähere Erläuterung siehe www.claytec.de/produkte/downloads, Artikel Wohnung + Gesundheit. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung bestimmter Werte nicht garantiert werden kann.

Weiterverputz Der Weiterverputz erfolgt nach vollständiger Trocknung, frühestens nach Abschluss möglicher Schwindrissbildung.

Arbeitsproben Untergrundeignung und Auftragsstärke sind in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen siehe „Arbeitsblatt Lehmputze“.

*Bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL 2009, S. 97).